

SAS (Semiconductor & Assembly Solutions) 事業部

製品紹介

ソルダーペースト

ソルダーペースト一覧（抜粋）

合金の特性は下部を参照ください

合金	フラックス	粒子径 (μm)	IPC規格	ハロゲン*	特徴
Pbフリー製品					
SAC305	CVP390	Type4/5/6/7	ROLO	ゼロ	グローバル調達性良好、微小溶融性良好
SAC305	OL233HF	Type4	ROLO	ゼロ	Telcordia準拠品、フレキシ基板のはんだボール軽減、濡れ広がり良好
SAC305	OM340	Type3/4	ROLO	ゼロ	ハロゲンフリー標準モデル、グローバルベストセラー製品
SAC305	OM353	Type4/5	ROLO	ゼロ	Type5での微小ドット溶融性良好（大気リフロー対応）、はんだボール低減（当社比）、枕不良対策ペースト
SAC305	WS9160	Type3	ORMO	ゼロ	市場実績No.1の水洗浄タイプ、ゼロハロゲン対応品
Inno lot	CVP390	Type4	ROLO	ゼロ	大気リフロー対応品、様々なご要望にお応え出来る広いプロセスウィンドウ
Sn/57.6Bi/0.4Ag	CVP520	Type3/4	ROLO	ゼロ	TVやプリンターでの実績多数、抜群の凝集性による挿入部品の一括リフロー工程を実現

合金	フラックス	粒子径 (μm)	IPC規格	ハロゲン*	特徴
HRL1	OM550	Type4/5	ROL0	ゼロ	大気リフロー対応、小～中サイズの基板用、反りの大きなBGAパッケージでも実装可能
ULT1	OM220	Type-3P	ROL0	ゼロ	PET基板向け超低融点はんだだ。150°C以下のリフローで実装可能
Pb含有製品					
63Sn/37Pb	RMA9170	Type3	ROL1	含む	MILスペックRMA規格準拠、航空宇宙、産業機器関連実績品
NT4S	RMA9154	Type3/4	ROL1	含む	車載実績No.1、無洗浄高信頼性タイプ

注* ゼロ : F, Cl, Br 不使用 フリー : F, Cl, Br 含有量各1,000ppm以下

合金の特性

SAC305

Pbフリー標準合金、民生品から車載品まで幅広い採用実績

Innolot

車載向け高信頼性はんだ合金、150°Cクリープ特性および耐振動特性に優れる

Sn/57.6Bi/0.4Ag

第一世代低融点はんだ合金、挿入部品の一括リフローによるトータルコスト削減が可能

HRL1

第三世代低融点はんだ合金、第一世代の良さを残しつつ強度を大幅に改善

Sn/Sb系

ダイアタッチ用高信頼性はんだ合金

63Sn/37Pb

Pb/Sn共晶標準合金

NT4S

Sn/Pbベース、チップ立ち抑制を目的とした合金組成